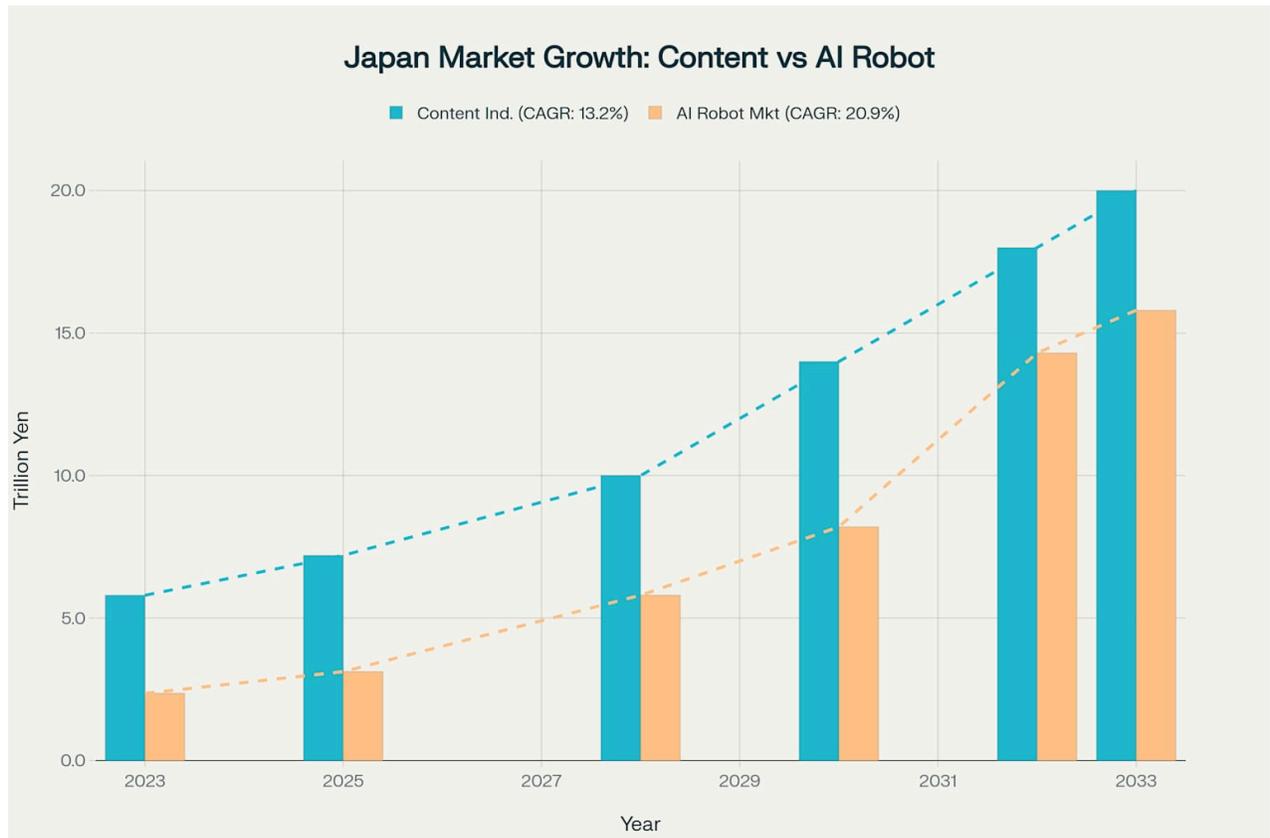


# レゾナックによるコンテンツ産業・AI搭載ロボット産業への参入戦略分析

日本政府が重要な成長戦略として位置づけるコンテンツ産業とAI搭載ロボット産業は、それぞれ2033年までに海外売上高20兆円、AI搭載ロボット市場では2032年までに世界市場規模95.4億ドル（約14.3兆円）という大きな成長ポテンシャルを持つ産業です<sup>[1] [2] [3]</sup>。レゾナックは、世界トップクラスの半導体・電子材料メーカーとして蓄積した技術力を活かし、これらの新成長分野への戦略的参入により、新たな収益基盤の構築と持続的成長の実現が期待されます。

## 1. 市場規模と成長機会

### 1.1 両産業の成長トレンド



Japanese content industry vs global AI robot market growth projections (2023-2033)

コンテンツ産業では、日本のコンテンツ海外売上が2023年の約5.8兆円から2033年には20兆円を目指す政府目標が設定されています<sup>[1] [3]</sup>。一方、世界のAI搭載ロボット市場は2025年の208.2億ドルから2032年には1,493.4億ドルへと年平均成長率32.5%で拡大する見込みです<sup>[2] [4]</sup>。

## 1.2 具体的な事業機会

政府は両産業の育成において以下の重点施策を推進しています：

### コンテンツ産業支援策：

- VFX・3DCGポストプロダクション振興への56.5億円の予算措置<sup>[5]</sup>
- Web3.0、仮想空間、AI技術を活用した新たな取組への支援<sup>[5]</sup>
- デジタルコンテンツ制作に係る産業集積創出<sup>[5]</sup>

### AI搭載ロボット産業支援策：

- AIロボット協会（AIRoA）への20億円投資<sup>[6]</sup> <sup>[7]</sup>
- ロボティクス分野でのソフトウェア開発基盤構築事業103億円<sup>[7]</sup>
- 次世代ロボット技術基盤構築事業への6億円新規予算<sup>[7]</sup>

## 2. レゾナックの現状と競争優位性

### 2.1 既存技術基盤の強み

レゾナックは以下の世界トップクラスの技術を保有しています<sup>[8]</sup> <sup>[9]</sup> <sup>[10]</sup>：

- **半導体材料領域**：CMPスラリー世界トップシェア、特殊ガス製品複数品目で世界シェアトップクラス
- **SiCエピタキシャルウェハー**：次世代パワー半導体材料で世界シェアトップクラス
- **AI活用材料開発**：計算情報科学研究センターによる材料探索の大幅効率化（従来比5分の1の時間）<sup>[11]</sup> <sup>[12]</sup>
- **高機能セラミックス**：アルミナ、窒化ホウ素などの放熱・絶縁材料<sup>[13]</sup> <sup>[14]</sup>

### 2.2 共創型イノベーション体制

レゾナックは「共創型化学会社」として、以下の革新的な取り組みを展開しています<sup>[15]</sup> <sup>[16]</sup>：

- パッケージングソリューションセンター（PSC）での産学連携
- JOINT2コンソーシアムによる14社との次世代半導体パッケージ開発
- オープンイノベーション活動による外部技術との融合
- 計算情報科学とAI技術を活用した「二刀流人材」育成<sup>[17]</sup>

## 3. コンテンツ産業への貢献戦略

### 3.1 技術貢献領域

## Resonac Tech Flow to Industries



Resonac's technology mapping to content industry and AI robot applications

レゾナックがコンテンツ産業に貢献できる主要領域は以下の通りです：

### 高性能GPU・AI半導体材料供給：

- 生成AI、VFX処理に必要な高性能GPU向け材料 [\[18\]](#) [\[19\]](#)
- HBM（高帯域幅メモリー）用絶縁接着フィルム（NCF）と放熱シート（TIM） [\[18\]](#)
- AI半導体向け材料の生産能力を従来の3.5～5倍に拡大予定 [\[18\]](#)

### デジタルコンテンツ制作インフラ：

- バーチャルプロダクション用LEDディスプレイ材料 [\[20\]](#) [\[21\]](#)
- メタバース・デジタルツイン技術向け高性能計算基盤材料 [\[22\]](#) [\[23\]](#)
- データセンター向け高効率冷却・電力管理材料

## 3.2 新規事業開発機会

コンテンツ産業のデジタル化推進により、以下の新たなビジネス機会が創出されています：

- **バーチャルスタジオ向け材料**：LED壁面システム、高精度センサー材料
- **クラウドゲーミング基盤**：サーバー用高性能冷却材料、低遅延通信材料
- **メタバースプラットフォーム**：没入型デバイス用材料、通信インフラ材料

## 4. AI搭載ロボット産業への貢献戦略

### 4.1 核心技術領域での貢献

AI搭載ロボット産業において、レゾナックは以下の重要技術領域で貢献可能です：

#### センサー材料：

- 高純度セラミックス材料によるセンサー精度向上 [13] [24]
- 圧電素子用特殊材料、MEMS用材料の開発
- 環境負荷の少ない鉛フリー材料の提供 [25]

#### アクチュエーター材料：

- 形状記憶合金、誘電エラストマー等のスマート材料 [25] [26] [24]
- 高効率モーター用SiCパワーデバイス材料 [27] [28]
- 人工筋肉向け機能性ポリマー材料 [26]

#### 高性能コンピューティング：

- AI処理用GPU向け高性能材料 [18] [29]
- エッジコンピューティング向け小型・高効率冷却材料
- 5G/6G通信モジュール用材料 [30]

### 4.2 産業横断的ソリューション

ロボット産業の用途拡大に伴い、以下の横断的な材料ソリューションが求められています：

- 産業用ロボット：高温・高負荷環境での耐久性材料
- サービスロボット：軽量化・省電力化材料
- 医療用ロボット：生体適合性・高精度制御材料

## 5. 現状とあるべき姿のギャップ分析

### 5.1 現状の制約要因

#### 技術面：

- 新産業向け専用材料開発の知見不足
- コンテンツ・ロボット業界との連携経験の限定性
- 川下アプリケーションへの理解深度

#### 事業面：

- 既存顧客との関係性に依存した事業構造
- 新規市場開拓に向けた営業・マーケティング体制の不備
- 異業種連携のためのビジネスモデル構築経験

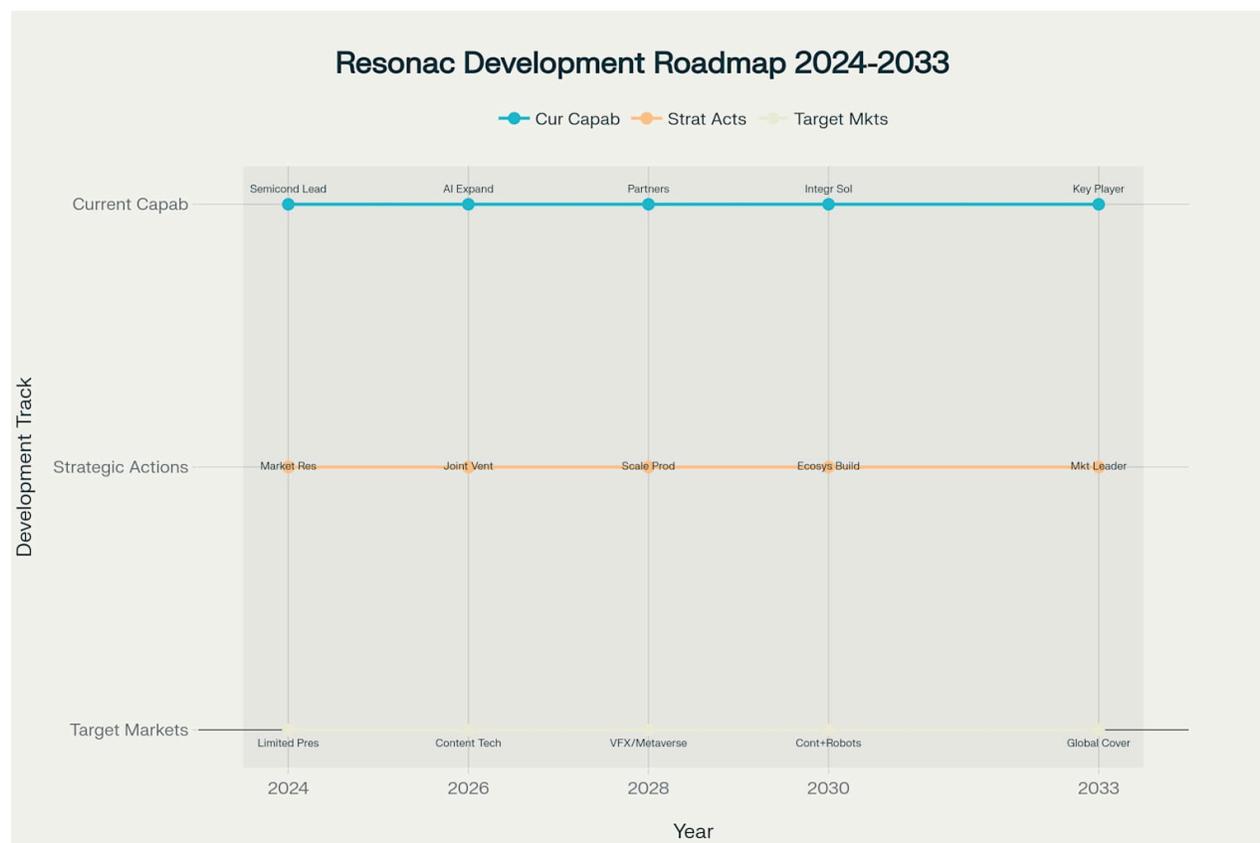
## 5.2 あるべき姿

### 2030年ビジョン：

- コンテンツ・ロボット両産業において材料ソリューションパートナーとしての地位確立
- 川上材料技術と川下アプリケーションを統合した新たな価値提案
- グローバル市場での競争優位性確保

## 6. 参入・成長シナリオ

### 6.1 段階的参入戦略



Resonac's strategic roadmap for entering content industry and AI robot markets (2024-2033)

### フェーズ1 (2024-2026年)：基盤構築期

#### 戦略的パートナーシップ形成：

- コンテンツ制作会社との協業プロジェクト開始
- ロボットメーカーとの材料開発連携強化
- 大学・研究機関との共同研究拡大

#### 技術開発投資：

- 計算情報科学研究センターのリソース7割を活用した新材料開発<sup>[11]</sup>
- AI活用による材料探索の更なる高速化

- 専門人材の戦略的採用・育成

**フェーズ2 (2026-2030年) : 市場参入・拡大期**

製品・サービス開発:

- コンテンツ制作向け専用材料ラインアップ構築
- ロボット用途向けカスタマイズ材料の商用化
- 統合ソリューションサービスの提供開始

生産体制確立:

- 新規市場向け生産能力の段階的拡張
- 品質管理体制の業界特化型構築
- グローバル供給網の最適化

**フェーズ3 (2030-2033年) : 市場リーダーシップ確立期**

エコシステム構築:

- 産業プラットフォームでの主導的役割確立
- 標準化活動への積極参画
- 次世代技術開発の先導

## 6.2 重点投資領域

分析結果に基づく戦略的優先順位は以下の通りです:

**最優先投資領域:**

- AI搭載ロボット向けセンサー・コンピューティング材料 (参入障壁低、成長率高)
- コンテンツ産業向けVFX/CG用材料 (市場規模大、技術適合性高)

**中期投資領域:**

- バーチャルプロダクション、メタバース向け材料
- ロボット用アクチュエーター材料

## 6.3 投資規模と期待収益

**投資計画:**

- 初期投資 (2024-2026年) : 約200億円 (R&D、設備、人材)
- 拡張投資 (2027-2030年) : 約300億円 (生産能力、海外展開)
- 総投資額 : 約500億円

**収益目標:**

- 2030年 : 両産業合計で売上高1,000億円
- 2033年 : 売上高2,000億円、営業利益率15%以上

## 7. 成功要因と推進体制

### 7.1 重要成功要因

#### 技術革新力：

- AI・計算科学を活用した材料開発スピードの圧倒的優位性維持
- 顧客ニーズに対する迅速な技術対応力
- 持続的なイノベーション創出体制

#### 顧客との共創力：

- 川下産業との深い連携による価値共創
- カスタマイズ対応力とソリューション提案力
- 長期パートナーシップの構築

#### 組織学習力：

- 新市場・新技術への適応力
- 異業種連携ノウハウの蓄積
- グローバル展開に向けた組織能力強化

### 7.2 推進体制

#### 専門組織設置：

- コンテンツ・ロボット産業担当の新事業開発部門設立
- 業界専門営業チームの組成
- 技術開発専門チームの編成

#### 外部連携強化：

- 戦略的パートナーシップの体系的構築
- オープンイノベーション活動の拡大
- 政府施策との連携強化

## 8. 結論

レゾナックは、世界トップクラスの半導体・電子材料技術と、AI活用による材料開発力を基盤として、成長著しいコンテンツ産業・AI搭載ロボット産業への戦略的参入が可能です。特に、高性能GPU用材料、ロボット用センサー・アクチュエーター材料において、既存技術の応用と新規開発により競争優位性を構築できます。

2024年から2033年にかけての段階的参入戦略により、総投資額500億円で2033年には両産業合計で売上高2,000億円の新たな収益基盤構築が期待できます。成功の鍵は、計算情報科学とAI技術を活用した圧倒的な材料開発スピード、顧客との深い共創関係の構築、そして持続的なイノベーション創出体制の確立にあります。

政府の産業育成政策と歩調を合わせ、「共創型化学会社」としての強みを活かした戦略的参入により、レゾナックは日本の新成長産業における重要なプレーヤーとしての地位確立が可能となります。

✻

1. <https://branc.jp/article/2025/06/27/1702.html>
2. <https://www.coherentmarketinsights.com/ja/人工知能AIロボット市場>
3. [https://www.meti.go.jp/shingikai/mono\\_info\\_service/entertainment\\_creative/pdf/20250624\\_1.pdf](https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/20250624_1.pdf)
4. <https://www.gii.co.jp/report/sky1687517-artificial-intelligence-robots-market-size-share.html>
5. [https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii\\_sihonsyugi/wgkaisai/contents\\_dai2/siryoushou3.pdf](https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/contents_dai2/siryoushou3.pdf)
6. <https://www.youtube.com/watch?v=BrC10MVWQoI>
7. <https://www.icr.co.jp/newsletter/wtr433-20250512-teshima.html>
8. <https://www.resonac.com/recruit/jp/field/>
9. <https://www.resonac.com/jp/corporate/digest.html>
10. <https://www.resonac.com/sites/default/files/2025-02/vision2024q4b.pdf>
11. <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000102176.html>
12. <https://www.resonac.com/jp/news/2023/12/21/2839.html>
13. <https://www.resonac.com/jp/products/innovation-materials/88>
14. [https://www.resonac.com/sites/default/files/2022-11/Filler\\_AS\\_20221028\\_v.2.pdf](https://www.resonac.com/sites/default/files/2022-11/Filler_AS_20221028_v.2.pdf)
15. <https://www.resonac.com/jp/corporate/resonac-now/20240731-3152.html>
16. <https://www.resonac.com/jp/rd/openinnovation.html>
17. <https://jbpres.ismedia.jp/articles/-/82258>
18. <https://www.resonac.com/jp/news/2024/03/29/3000.html>
19. <https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2404/03/news057.html>
20. <https://cg-studio.jp/2025/04/15/what-is-vfx/>
21. <https://tbs-mri.com/n/n6b178554754c>
22. <https://media.datafluct.com/digital-twin/>
23. [https://newtrace.net/media/metaverse\\_0003](https://newtrace.net/media/metaverse_0003)
24. <https://www.oit.ac.jp/laboratory/room/373/index.html>
25. <https://orutedia.com/actuator/>
26. <https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/02048/>
27. [https://sumitomoelectric.com/jp/sites/japan/files/2021-10/download\\_documents/J193-11.pdf](https://sumitomoelectric.com/jp/sites/japan/files/2021-10/download_documents/J193-11.pdf)
28. <https://criepi.denken.or.jp/intro/nenpo/2008/08bunya410.pdf>
29. <https://go.orixrentec.jp/rentecinsight/it/article-440>
30. <https://www.businessresearchinsights.com/jp/market-reports/cpu-and-gpu-market-120302>